



2021年9月30日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O
代表者名 代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸
(コード: 3 4 3 6 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 澁谷 博史
(TEL. 03-5444-3915)

設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、設備投資を実施することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設備投資の理由

300mm 半導体用シリコンウェーハの需要は堅調に拡大し、300mm 半導体用最先端シリコンウェーハは現状の当社グループの製造設備では供給が需要に追い付かない状況となっております。

当社は、300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ市場における供給責任を果たすために市場の成長に見合った段階的な増産を継続して参りました。しかしながら、足許では当社グループの国内既存建屋内の増産スペースが尽きていることから、300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの段階的な増産を継続することを可能とするために、当社は新たな建屋、ユーティリティ設備および製造設備にかかる設備投資を決定いたしました。併せて当社子会社である SUMCO TECHXIV 株式会社において建屋の増築、ユーティリティ設備および製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。

なお、下記記載の公募による新株式発行の詳細につきましては、2021年9月30日付で公表いたしました「新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 設備投資の内容

- a) 対象資産の名称 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ製造用建屋・ユーティリティ設備・製造設備
- b) 所在地 佐賀県伊万里市（当社）、長崎県大村市（SUMCO TECHXIV 株式会社）
- c) 投資予定額
- | | |
|--------------------|----------|
| 当社 | |
| 建屋・ユーティリティ設備 | 786 億円 |
| ウェーハ製造設備 | 1,229 億円 |
| 合計 | 2,015 億円 |
| SUMCO TECHXIV 株式会社 | |
| 建屋・ユーティリティ設備 | 165 億円 |
| ウェーハ製造設備 | 107 億円 |
| 合計 | 272 億円 |

d) 資金調達方法 公募による新株式発行および自己資金

e) 今後の予定 2022年より建屋の建設およびユーティリティ設備の設置を進め、2023年からは製造設備を導入のうえ順次生産を開始し、2023年内にはSUMCO TECHXIV株式会社の、2024年内には当社の本設備投資の完了を予定

3. 今後の見通し

本設備投資による当期業績への影響はありません。

以 上